

## 通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	平安证券：陈福栋；弢盛资产：陶星辰；博时基金：赵宪成；工银瑞信：万力实；摩根基金：宋敬祎；国联民生：王晔；南方基金：竺绍迪、吴春林；中信证券：王子源；富国基金：罗擎；长城基金：余泽璇；长江资管：杨书权；中庚基金：徐润齐；平安基金：江正清；长信基金：袁梦镜；银河基金：黄心叶；财通证券：唐佳、詹小瑁；泉果基金：赵浩
时间	2026年1月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司概况</b></p> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于2025年2月13日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科</p>

技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度分别实现营收 214.29 亿元、222.69 亿元、238.82 亿元和 201.16 亿元。公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度的归母净利润分别为 5.02 亿元、1.69 亿元、6.78 亿元和 8.60 亿元。

## 二、投资者关注的主要问题

### 问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

### 问题 2：简单介绍一下本次向特定对象发行股票的目的？

回复：本次募投项目均围绕关键领域芯片产品及国产替代的战略定位，协同下游头部芯片原厂，加速本土产能建设与供应体系重构，在关键技术节点上形成更具韧性的本土半导体产业链格局；本次募投项目的主要投向为下游高景气度、国产替代加速、技术密集的增长领域，提升现有产能规模与供给弹性，以更好地承接下游市场复苏及结构性增长机遇，为国内外龙头客户提供更

稳健的本土化封测支撑，并为承接新兴优质客户奠定产能基础，巩固公司在全球封测产业的领先地位；本次募投项目将夯实公司在高端封测领域的综合竞争力与战略地位，推进公司产品结构从“广覆盖”向“强支点”的升级，匹配下游技术及市场的发展趋势。

**问题 3：本次发行的发行对象范围有哪些？**

回复：本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

**问题 4：公司本次发行“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”具体的项目计划是什么？**

回复：本项目计划投资 109,955.80 万元提升汽车等新兴应用领域封测产能，项目建成后年新增汽车等新兴应用领域封测产能 50,400 万块。本项目实施将有助于公司进一步调整产品结构、扩大生产规模、增强抗风险能力，巩固并增强公司在车载等封测领域的优势地位。

**问题 5：请简单分析一下本次募投项目的可行性。**

回复：公司具备丰富的技术储备和客户基础，不涉及面向全新的技术研发或开拓全新的市场风险，具备实施本次募投项目能力。公司建有国家级和省级的高层次创新平台，承担多项国家级科技攻关项目，拥有一支专业的研发队伍，已成功切入主流的高端封测领域并持续进阶。在坚实技术的基础上，公司主动融入全球半导体产业链，积累了国内外市场开发的经验，充分理解不同

市场及客户群体的要求，并针对行业前沿的需求进行产品开发。公司已在不同细分领域积累了广泛的头部客户资源，形成长期稳定的合作关系。

**问题 6：本次募投项目“晶圆级封测产能提升项目”是顺应下游技术发展趋势而设立的吗？**

回复：是的，晶圆级封装作为先进封装的重要技术方向，已成为满足高性能芯片高频化、轻薄化、小型化趋势的关键工艺路径。其核心工艺在于以晶圆整体为封装单元，在晶圆尚未切割前完成凸块形成（Bumping）、重布线（RDL）、晶圆测试、封装成型等关键步骤，属于对前段晶圆制造环节的延伸。相较引线焊接等传统封装形式，晶圆级封装通过上述所形成的凸块，缩短芯片到外部电路的连接距离，并通过优化互联材料，显著降低了寄生电感、电容及信号延迟，提升了信号传输速度与稳定性，并在封装尺寸、互联密度、信号完整性、热管理能力等方面具备明显优势。作为关键技术环节，晶圆级封装亦是其他诸多先进封装工艺的前序步骤，在先进封装产业中具有重大意义，可实现多场景的协同与互补。

公司本次加强晶圆级封装能力建设，系基于对先进封装技术演进趋势的系统判断，有助于公司构建长期支撑先进计算、高速接口、小型器件封装需求的技术优势，提升面向头部客户的协同设计、交付能力与技术服务深度，进一步夯实公司在高端封测领域的战略卡位。

**问题 7：2025 年整体业绩情况如何？**

回复：公司已于 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《2025 年度业绩预告》，2025 年度预计归属于上市公司股东的净利润为 110,000 万元–135,000 万元，预计同比增长 62.34%–99.24%；2025 年度预计扣除非经常性损益后的净利润为 77,000 万元–97,000 万元，预计同比增长 23.98%–56.18%，变动原因主要系 2025 年内，全球半导体行业呈现结构性增长，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2025 年业绩。

附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 21 日